

インタビュー

株式会社メイコー



代表取締役社長 名屋祐一郎 様

1943年愛知県生まれ。

1975年名幸電子工業設立。現在に至る。

<会社概要>

設立年月日 昭和50年（1975年）11月25日

本社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上5-14-15

事業内容 電子回路基板等の設計、製造販売およびこれらの付随業務の電子関連事業

資本金 128億88百万円

従業員数 グループ13,210名 *2019年4月1日現在
(国内:1,293名 海外:11,917名)HP: <https://www.meiko-elec.com/>

Q1. 会社の概要についてお聞かせ下さい。

株式会社メイコーは1975年に設立された電子回路基板（プリント配線板）専門メーカーです。創業から現在に至るまで、プリント配線板の設計・開発・製造を軸に事業を展開しておりますが、現在ではEMSから各種メカトロニクス開発まで柔軟に対応する、エレクトロニクス分野のトータルソリューションカンパニーに成長しました。2017年度の連結売上高は1085億円となり、2018年度も増収増益を予定するなど継続して成長しています。工場は国内に神奈川、福島、山形、石巻の4工場あり、海外には中国の広州と武漢ならびにベトナムのハノイに2工場あります。



Q2. 業務内容についてお聞かせ下さい。

新事業開発部はメイコーの研究開発センターを中心に活動しており、主に放熱基板の開発を行っております。放熱

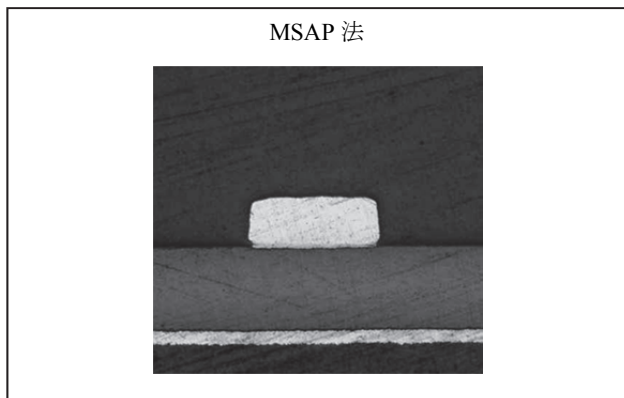
基板は用途としては自動車のLEDヘッドランプに使われるメタルベース基板や、パワー半導体実装されるパワーモジュール用途のメタルベース基板に主に取り組んでいます。開発のポイントとなる、高信頼性の放熱基板の開発では、有機の樹脂に無機の熱伝導性フィラーをバランスよくブレンドしていく材料技術や、また生産性を意識して材料を基板化していく加工技術など非常に広い領域での技術が必要となります。



こうした高信頼性の放熱基板を開発するにあたり、評価設備も充実させており、現在は基板メーカーとしては珍しいレベルで、材料評価装置ならびに熱伝導率の測定装置を導入しています。

また、基板の構造的に放熱性を向上させる開発も行っており、機械的な加工装置についても最新の設備の導入を図っています。化学、電気、機械といった幅広い領域でのパッ

クグラウンドを持つ技術者が、それぞれの特色を活かして、新しい基板の開発に従事しています。



Q3. 学会との係わりについてお聞かせ下さい。

日本材料科学会に関しては、当社が以前からお世話になっている関東学院大学の渡邊教授からご紹介を頂きました。関東学院大学の材料・表面工学研究所は基板関係では非常に強いバックグラウンドを持っており、弊社含め多くの卒業生が業界内で活躍しております。そうした事もあり賛助会員に申し込みさせて頂きました。

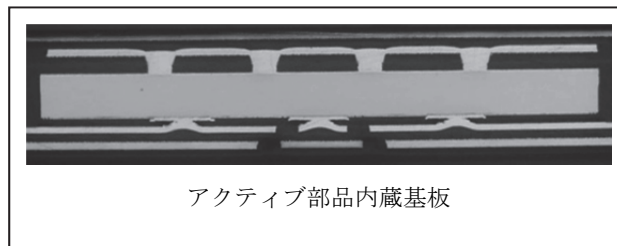
Q4. 現在危惧していることや今後の展望についてお聞かせ下さい。

現在各種の開発は社内だけでなくパートナー企業とも行っておりますが、開発の一層の加速が必要であると感じております。放熱基板の材料技術に関しては、日本は未だに世界で一流であると考えておりますが、アジアの競合国もこの分野に猛烈な勢いで参入してくることが予想されており、差別化技術の確立が必要です。また、欧米では放熱基板の材料技術がそれほど高くないと思われませんが、彼らは別のアプローチで放熱基板技術を追求しており、日本がガラパゴス化する可能性もない訳ではないと考えています。そうしたリスクを避ける為に、バランスよくフレキシブルに動けるようにしておく必要があると思います。

Q5. 会社の一押しについてお聞かせ下さい。

メイコーの会社としての一押しは、比較的安定して成長を続けていることでしょうか。また、国内工場は東日本大震災のような異常事態を除けば、これまで一度も閉鎖される事なく、事業を継続していますし、海外工場についても突発的な事件を除けば安定して操業を続けています。メイコーの強みは時流に乗って売れる商品を開発しており、

またそれを支える強い製造力があるという事でしょうか。また、当社は比較的に自由な社風で、手を挙げれば色々な事をやらせてもらえます。メイコーで鍛えられれば、どこにいても通用するのではないかと思います。



Q6. 学会に期待することについてお聞かせ下さい。

日本材料科学会は基板と関連する内容も多いのですが、それ以外の分野の内容も数多く発表されており、また当社の通常業務の延長では知りえなかった方々との出会いがあるのではないかと考えています。異なる分野や異業種の方の技術や話には多くの示唆が含まれていると思いますので、そうしたところからの気づきが新たな開発の原動力になると思っております。

Q7. 社会に対してのアピールポイントをお聞かせ下さい。

現在当社で開発を進めている放熱基板技術については、高信頼性の車載ヘッドランプ用途の場合にはより明るく、より安全な運転を支える技術になります。また、パワーモジュールは進化するパワー半導体に追随して、高効率・低消費電力を実現するデバイスに使われる技術です。21世紀の進歩する世の中で、当社の技術が少しでもお役に立てれば、とてもうれしいです。



お忙しい中インタビューに応じて頂きました。期して感謝の意を表します。

(日本材料科学会 編集委員長 渡邊充広)